

社名

部門

ご担当様

製品名 **FutureNet MA-X300/M-P**

御承認仕様書 1.1 版

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2024 年 11 月 22 日
センチュリー・システムズ株式会社

1. 一般仕様

機 能		内 容
プロセッサ		
CPU		TI Sitara AM6412 (Dual 64-bit ARM Cortex-A53)
	内部動作周波数	1GHz
MCU		TI MSP430FR2476 (FRAM 64kB, SRAM 8kB)
メモリ		
DRAM		DDR4-SDRAM
	メモリ容量	2GByte
	動作周波数	DDR 800MHz (1600MT/s)
eMMC NAND FLASH		eMMC 5.1
	メモリ容量	10GByte / Enhanced mode (pSLC)
Serial NOR FLASH		QSPI FLASH MEMORY (Boot device)
	メモリ容量	8MByte
インタフェース		
ETHER 0/1		10BASE-T _e /100BASE-TX/1000BASE-T
ETHER 0/1	インタフェース	2 ポート
	コネクタ	RJ-45
	動作モード	Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDI-X 対応
	PoE PSE (給電) (ETHER 0 のみ対応)	IEEE802.3bt Class 3 の電力を供給 周囲温度 50℃時 : 最大 15.4W 周囲温度 60℃時 : 最大 7.5W (ただし USB 給電しない場合) ソフトウェアによる給電 ON/OFF 制御 (シャットダウンモード中の給電は不可)
CONSOLE		USB 2.0 Full-Speed device (USB-Serial ポート)
CONSOLE	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	USB micro B
	USB-Serial デバイス	FTDI FT234XD (TXD/RXD, ハードフロー制御無し)
	最大転送速度	115.2kbps
RS-232		TIA/EIA-232 (RS-232) シリアルポート
RS-232	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)
	最大転送速度	115.2kbps
	転送モード	全二重
	モデム信号	DTE (DTR, DSR, CTS, RTS, CD, RI)
RS-485		TIA/EIA-485 (RS-485) シリアルポート
RS-485	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	スクリューレス端子台 5/10 ピン
	最大転送速度	115.2kbps
	転送モード	半二重
	終端抵抗	120Ω 内蔵 (外部ジャンパ線により ON/OFF 可能)
SD Card		SD メモリカード
SD Card	インタフェース	1 スロット
	コネクタ	SD カードスロット
	最大転送速度	25MByte/sec (SD mode 4bit data)
	ブート機能	MMC ブート対応 (CONFIG スイッチでブートデバイス切り替え)

機 能		内 容
インタフェース		
	USB	USB 2.0 Host Interface
		1 ポート
		コネクタ
		USB Type A
		最大転送速度
		USB 2.0 High speed
		電源供給能力
		供給電流制限 1A

機 能		内 容
インタフェース		
	接点入力	
	ポート数	3CH DIN S0/S1 : 外部入力 DIN T0 : PoE 制御用内部接続
	コモン	2CH／コモン
	入力電圧	DC12V～24V±10% (DC10.8V～26.4V)
	入力閾値	ON : DC10V 以上 OFF : DC3V 以下
	入力電流	約 2.5mA～5mA
	入力インピーダンス	約 6k Ω
	入力フィルタ	ソフトウェア
	ソフト割り込み	チャンネル毎に設定（立ち上がり・立ち下がりエッジ選択可）
	絶縁方式	フォトカプラ絶縁
	絶縁耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子～内部回路間
	コネクタ	スクリーレス端子台 3/10 ピン
	接点出力	
	オープンコレクタ出力	
	ポート数	2CH DOUT S0 : 外部出力 DOUT T0 : PoE 制御用内部接続
	コモン	1CH／コモン
	負荷電圧	DC26.4V(最大)
	負荷電流	50mA(最大)
	ON 電圧	DC 1.1V 以下 (最大負荷時)
	OFF 時漏洩電流	0.1mA 以下
	保護機能	過電流保護
	絶縁方式	フォトカプラ絶縁
	絶縁耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子～内部回路間
	コネクタ	スクリーレス端子台 2/10 ピン

機 能		内 容
インタフェース		
	PCIe 2.0	NVMe SSD モジュール
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	M.2 (M key) 2280/2242 サイズ対応
	最大転送速度	PCIe 2.0 x1
	SSD 容量	2TB (1920GByte) Swissbit 製 N3002 series 搭載 (NVMe 1.4, TLC 3D NAND Flash, Powersafe function)

機 能		内 容		
表示機能				
	LED			
		POWER	電源ステータス	赤色/緑色 2 色 LED ソフト制御 (電源 ON 時緑色点灯)
		STATUS 1	システムステータス 1	赤色/緑色 2 色 LED ソフト制御
		STATUS 2	システムステータス 2	赤色/緑色 2 色 LED ソフト制御
		STATUS 3	システムステータス 3	赤色/緑色 2 色 LED ソフト制御
		SSD	SSD ステータス	赤色/緑色 2 色 LED 赤色 ハード/ソフト制御 緑色 ソフト制御
	ETHER 0/1	SPEED LINK/Activity	橙色/緑色 2 色 LED RJ-45 コネクタ 緑色 1 色 LED に内蔵	
スイッチ				
	INIT スイッチ	プッシュ・スイッチ(ソフト検出可)		
	OPTION スイッチ	プッシュ・スイッチ(ソフト検出可)		
	CONFIG スイッチ	モード設定用 4bit DIP スイッチ		
監視機能				
	内部温度センサ	I2C 温度センサデバイス		
	内部電圧監視	PMIC による電圧監視		
	入力電圧監視	I2C A/D コンバータによる電圧監視		
	LOG 保存	FRAM 内蔵 MCU による常時 LOG・イベント保存		
スリープ機能				
	スリープモード	シャットダウンモード(CPU Power OFF/コールドスタート)		
	スリープ条件	ソフトウェアコマンド設定		
	シャットダウンモード ウェイクアップ条件	・DIN Port ・RTC タイマ ・OPTION スイッチ ・MCU Request (それぞれソフトウェアの実装による)		
カレンダー機能				
	リアルタイムクロック	I2C RTC デバイス		
	バックアップ電池	3V リチウム電池		
瞬時停電バックアップ機能				
	給電方式	双方向チャージ・バック式レギュレータ		
	給電時間	約 500ms (負荷状態による)		
	通知機能	停電発生をホスト CPU および MCU へ通知 MCU による停電イベントおよび発生時刻記録		

機 能		内 容	
外形寸法(突起物除く)			
W(幅)		179.0mm	
D(奥行き)		157.0mm	
H(高さ)		42.0mm	
重量(アダプタ・ケーブル等除く)			
本体		約 980g	
AC アダプタ		約 240g (AC ケーブルを除く)	
電源			
本体 DC 入力電圧		DC12V (DC9V～DC14.5V)	
本体電源コネクタ		2 ピン ネジフランジ付きソケット(Phoenix contact MC コネクタ)	
本体 FG 端子		M4 ねじ端子	
消費電流	DC12V	約 2.37A／最大 (PoE 15.4W 供給時)	
	DC12V	約 0.365A／待機 (CPU アイドル)	
	DC12V	約 1.35mA／スリープ (シャットダウンモード)	
発熱量(最大)		46.9kJ (約 11.2kcal)	
バックアップ電源		カレンダー機能用リチウム電池 (ソケット式)	
環境条件			
動作環境		温度: -20℃～+60℃	
		湿度: 10%～90%RH (結露なきこと)	
保存環境		温度: -20℃～+70℃	
		湿度: 10%～90%RH (結露なきこと)	
冷却方式		自然空冷	
MTBF (推測値)		138,970h 以上	
規制・認証			
電波障害自主規制		VCCI Class A	
安全基準		社内基準準拠	
静電気放電イミュニティ		IEC 61000-4-2 (JIS C61000-4-2) レベル 3	
放射無線周波電磁界イミュニティ		IEC 61000-4-3 (JIS C61000-4-3) レベル 3	
電氣的ファストランジェント ／バーストイミュニティ		IEC 61000-4-4 (JIS C61000-4-4) レベル 2	
サージイミュニティ		IEC 61000-4-5 (JIS C61000-4-5) レベル 2	
伝導妨害イミュニティ		IEC 61000-4-6 (JIS C61000-4-6) レベル 2	
耐振動性		-	

* 上記仕様は現時点の内容を示し、今後、変更する場合があります。

2. インターフェース詳細仕様

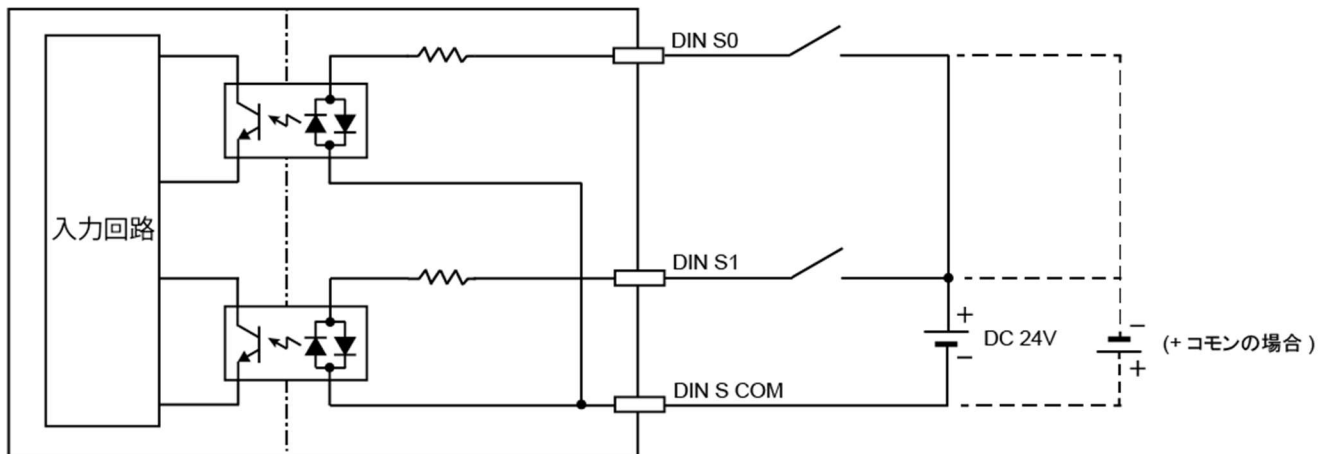
2. 1 DIO コネクタピン配置

DIO コネクタ ピン配置表

PIN No.	接点グループ	接点出力ピン名称	機能
6	DIN S	DIN S0	DI_00
7		DIN S1	DI_01
8		DIN S COM	DI コモン S
9	DOUT S	DOUT S0	DO_0
10		DOUT S COM	DO コモン S

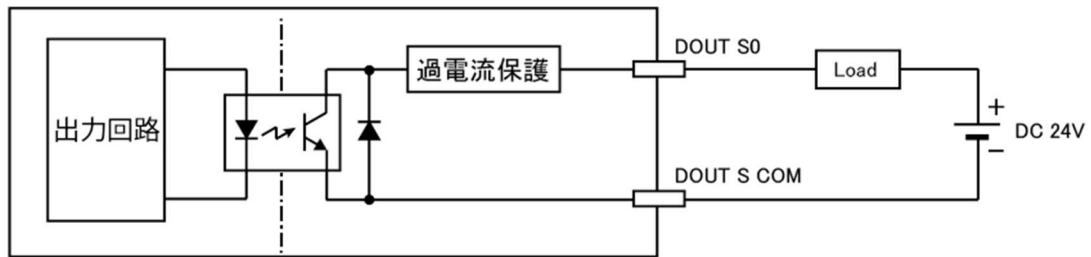
2. 2 DI 接点入力等価回路

DI 部はフォトカップラ及び電流制限抵抗により構成される。また、外部電源の接続方法によりマイナスコモン、及びプラスコモンの機器と接続が可能。グループ毎に共通コモンとなっている。



2. 3 DO 接点出力等価回路

DO 部はフォトカプラ及び過電流保護素子により構成される。グループ毎に共通コモンとなっている。



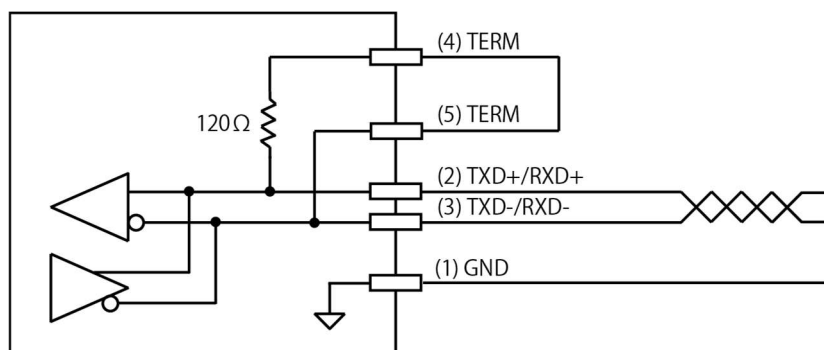
2. 4 RS-485 PORT コネクタピン配置

RS-485 PORT ピン配置表

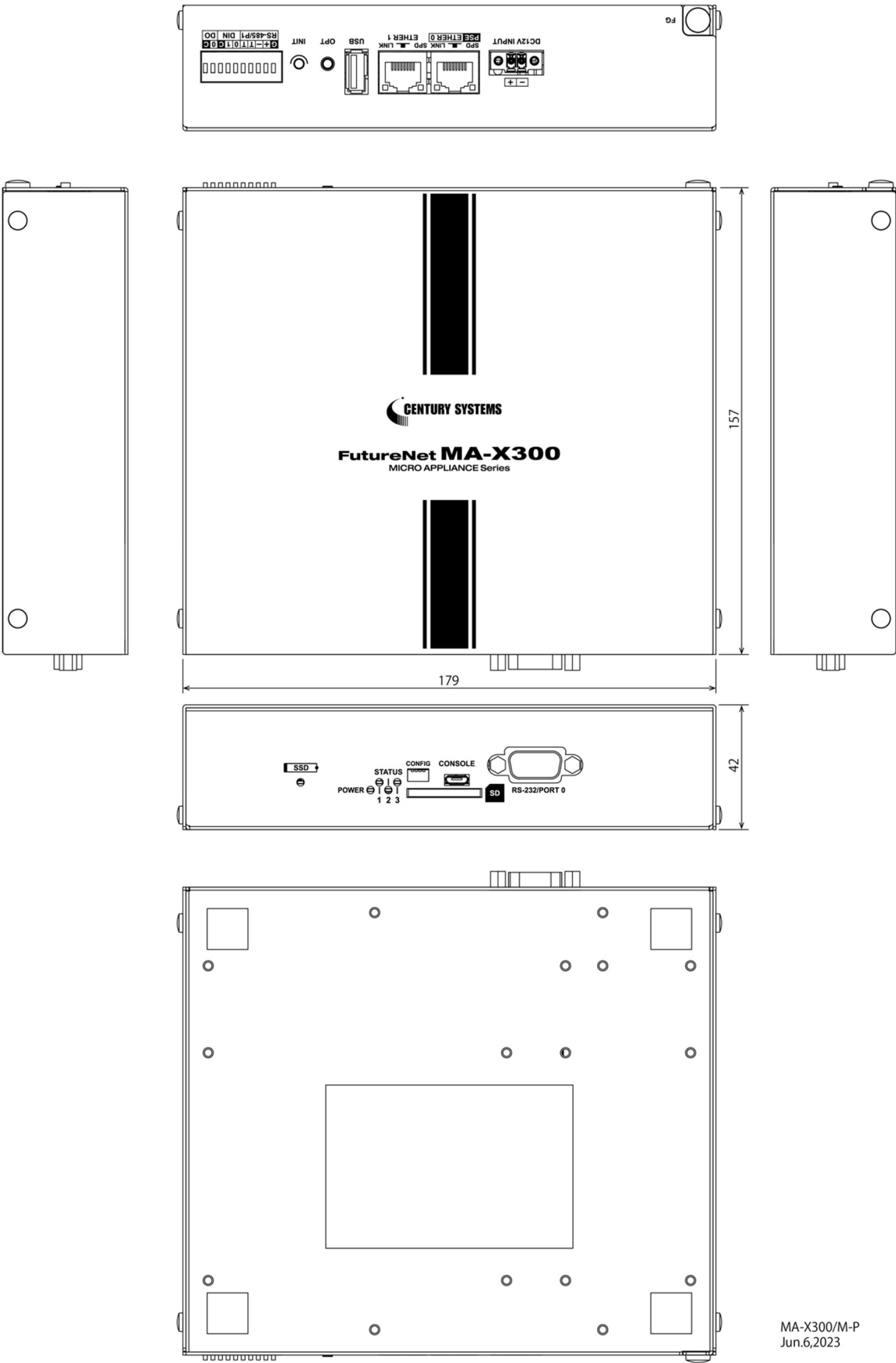
PIN No.	信号 ピン名称	機能
1	GND	コモン・シグナルグラウンド
2	+ (POS)	B (TXD+/RXD+)
3	- (NEG)	A (TXD-/RXD-)
4	TERM	120Ωターミネーション
5	TERM	120Ωターミネーション

2. 5 RS-485 PORT 等価回路

RS-485 ポートコネクタのピン(4)TERM とピン(5)TERM を外部でループバック接続することにより、RS-485 ポートに終端抵抗を挿入することができる。接続は最短のケーブルで行うこと。



3. 外観図



MA-X300/M-P
Jun.6,2023